

LEAD FREE SOLDER PASTE

CW 洗浄可能タイプ
優れた洗浄特性を有しております。

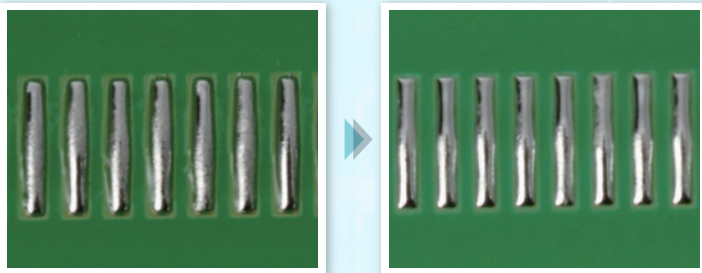
Fine Solder



Product Features 製品特性

■ 優れた洗浄性能

高級アルコール系洗浄剤だけでなく、ハロゲン化炭化水素系洗浄剤など、各種洗浄液に対応しております。



■ 試験条件

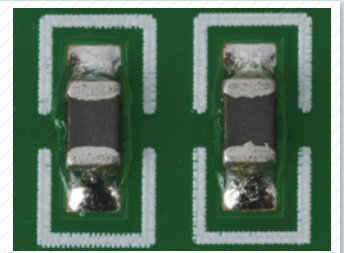
洗浄液：アサヒクリンAK-225AES 洗浄時間：1分
洗浄温度：15℃ 洗浄方法：浸漬揺動

■ 高い信頼性と作業性を維持

洗浄可能ソルダペーストでありながら、無洗浄ソルダペーストと同等の作業性・信頼性を維持しています。

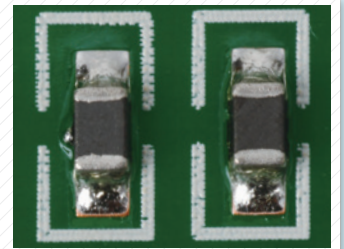


はんだボールの発生もなく
非常に良好な濡れ性を確保している



○ 他社相当品 ○

洗浄することを前提に
はんだボールの発生を許容している



項目	FLF01-CW	試験規格
合金組成	Sn96.5%-Ag3.0%-Cu0.5%	JIS Z3282
固相線温度	約217℃	JIS Z3282
液相線温度	約219℃	JIS Z3282
はんだ粉末サイズ	20~38μm(Type4)	JIS Z3284(J-STD-005)
フラックス含有量	10.50%	JIS Z3197
ハライド含有量	0.03%	JIS Z3197
粘度特性	190Pa·s	JIS Z3284
チクソトロピー指数	0.53	JIS Z3284
銅板腐食試験	合格	JIS Z3197
絶縁抵抗試験(85℃ 85%RH 168hr)	1.0×10 ⁹ Ω以上	JIS Z3197
マイグレーション試験(85℃ 85%RH 1,000hr)	異常なし	JIS Z3197
広がり率	86%	JIS Z3197

